

台塑勝高科技股份有限公司 114 年度營業報告書

壹、114 年度營業報告

全球半導體市場114年呈現出明顯的兩極化發展態勢。在AI用數據中心領域，先進邏輯產品及記憶體的需求大幅成長，推動12吋先進製程矽晶圓的強勁需求。然而，用於民生、工業及汽車領域的成熟製程產品雖已出現觸底跡象，但受客戶庫存調整影響，矽晶圓銷售仍持續面臨嚴峻挑戰。

面對半導體如此迅速變化的市場，加上中國大陸競爭廠商價格競爭，本公司全體員工戰戰兢兢，除持續以產品品質優勢，強化現有客戶的「Base Wafer」地位外，靈活調整銷售策略，持續推行製程自動化，並依據訂單進行適切的人員配置及專注成本降低活動，全力透過「以低成本來製造高品質產品」的使命，強化公司競爭力以確保公司營收及利益。

另為順應國際趨勢與投資人對永續治理日益提高的期待，強化本公司在全球供應鏈的長期競爭力，我們持續以更高標準推動 ESG（Environment、Social、Governance）整體策略，將 ESG 視為推動企業價值與韌性的重要引擎，將環境韌性、人才培育、供應鏈責任與高效治理全面納入經營核心，形成由董事會監督、管理階層驅動、各單位共同落實的治理循環。透過目標導向、數據治理與跨部門共同合作，強化客戶、員工和股東對本公司信任感，以環境面降低風險與成本，以人群面凝聚人才與社會信任，以治理面強化決策與紀律。我們相信，唯有將 ESG 永續思維及手段自然融於日常營運與供應鏈上下游運行之中，方能持續創造對地球、社會與股東皆具意義且可衡量的長期價值，並以透明負責的態度，攜手利害關係人共同建築更具韌性的永續未來。

茲將本公司 114 年度產銷狀況及營運情形說明如下：

一. 產銷狀況：

本公司持續聚焦於矽晶圓核心業務的穩定生產與市場拓展，全年總生產量達 6,614 千片，銷售量為 6,643 千片，銷售量略高於生產量，反應市場需求的穩定與供應鏈調度的靈活應對。產品銷售總值達新台幣 123 億 3,429 萬元，其中內銷金額 103 億 8,157 萬元，佔總銷售值的 84%，外銷金額 19 億 5,272 萬元，佔總銷售值的 16%。此銷售結構顯示，本公司仍以台灣本地市場為主要營收來源，同時積極拓展國際市場，特別是在東南亞與美國地區的客戶持續穩健成長。

二. 營運情形：

114 年合併營業收入為 123 億 3,429 萬元，較 113 年衰退 0.7%，扣除營業成本 105 億 1,622 萬元及管銷費 8 億 2,216 萬元，營業利益為 9 億 9,591 萬元，加計營業外支出 2 億 1,737 萬元，114 年稅前利益為 7 億 7,854 萬元，較 113 年衰退 52.2%。

貳、115 年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望115年，全球半導體產業正處於歷史性轉折點。根據國際半導體產業協會（SEMI）與市調機構Omdia的預測，全球半導體市場規模將正式突破兆美元門檻，這不僅是景氣循環的反彈，更是一場由人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用電子與資料中心所驅動的「結構性需求革命」。

在過去二十年中，半導體需求成長主要來自消費性電子產品，例如智慧型手機與個人電腦，但 115 年的需求結構已根本改變，AI 模型訓練與推論對算力需求呈指數成長，帶動

GPU、AI ASIC、HBM 記憶體與先進封裝需求同步爆發，使半導體產業發展邏輯從「終端需求導向」轉變為「算力基礎建設導向」。這種需求結構的轉換代表產業景氣循環週期將被拉長，因為 AI 基礎設施建設屬於長期投資，而非短期消費電子更新週期，因此，115 年半導體產業不再只是科技產業的一部分，而是全球經濟基礎建設的一環。

面對半導體市場改變，對矽晶圓產業而言，是承接過去幾年供需調整後的重要轉捩點。矽晶圓作為半導體製造的核心基礎材料，其市場變化代表了整個科技供應鏈對 AI、先進製程與新興應用的需求動能。故本公司未來發展主軸將以「高階晶圓市場深化布局」、「高附加價值產品比重提升」、「國際市場拓展」及「技術能力持續升級」為主力，以復甦趨勢顯著的記憶體產品為核心，並擴大先進晶圓代工客戶之銷售，持續往全能生產邁進。同時，秉持「與客戶共同創造雙贏」的理念，緊密跟進客戶市場需求，積極參與客戶新產品開發專案，確保產品佈局與市場趨勢同步。

在 ESG 方面，持續發展永續生產技術，降低碳排放與對環境的影響，本公司為使「氣候變遷因應法」碳費收取對公司影響減為最低，除擴大持續推行節能減碳活動，爭取最優惠的碳費費率外，在既有及新建廠房屋頂進行太陽能光電設置，已導入再生能源，使用綠電，減少碳排放，落實碳中和。持續開發低能耗生產技術，優化矽晶棒生長與矽晶圓切割製程，善用 AI 運用，降低能耗，提高生產效率。此外，電子商務平台已設置多年，攜手供應商共同減碳，除盤查各家供應商減碳效果外，也可共同分享節能減碳經驗，並以減碳效果績優的供應商為優先採購對象，一同為環境共創美好。

面對全球環境變化下，本公司以永續經營為目標，為健全公司營運，訂定下列活動，並與全體員工共同推進建立能靈活應對全球環境與半導體景氣急速變化的公司體制，期待 115 年將是成長的一年。

一. 徹底遵守法令及強化安全、環境管理體制

- 以「安全至上」為方針，徹底執行安全作業。
- 推動發生地震、風災、水災等災害時的業務持續計畫。
- 實施「零事故」推動計畫，防範重大事故、環境事故、交通事故的發生。
- 透過 ESG 活動，履行企業責任，為社會的永續發展作出貢獻。
- 強化資訊安全對策。

二. 「品質優先」的工程管理與持續推動「安定生產」

- 提供客戶信賴的產品供給及保證系統：實現零缺陷、並強化預防異常流出措施。
- 藉由可視化、自動化技術的展開以強化製程管理；推動 1 σ 活動與提升工程能力。
- 藉由供應鏈的強化，建立穩定的輔助材料供應體制。
- 面對客戶需求與客訴，各部門需迅速共同應對。
- 嚴格遵守客戶交期，達成 100% 的準時交貨率 (OTD On-Time Delivery)。
- 積極向客戶提出品質提升方案，提前排除可能影響未來銷售的潛在風險因素。

三. 推動因應市場及環境變化的行動

- 增加與客戶面對面的機會，深度交流，力求成為顧客首選的公司。
- 積極協助客戶的新產品開發，並爭取 Base Wafer 的地位。
- 針對客戶的臨時需求，產銷一體共同合作對應。

四. 徹底推動合理化，力求成為具備成本競爭優勢的公司

- 藉由自動化與工程改善提升人員生產性。
- 持續推動成本降低活動，建立能在市場價格下仍獲利的成本結構。
- 定員制之落實，並持續提升人員生產性。

五. 藉由 TPM 活動的推動，提升工廠體質

- 將 TPM 作為安全、品質、成本、生產性所有改善活動的根基。
- 持續推動 TPM 活動，並維持健全的設備狀況。